

## 应用介绍

### 特点

一款单组份高导热硅胶粘接剂，加热高温固化，具有较强耐高温性及稳定的高可靠性；受热流动性好易于器件的固定及粘接；尤其适用于热敏感器件芯片粘接固定

### 粘接材料

金属，塑料/PCB，玻璃，陶瓷等

### 典型应用

LED 芯片固晶散热粘接

## 固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	硅胶树脂	
颜色	白色	
粘度(cps)	28000	5rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件	2hrs@160°C	
有效期@ -5°C,月	6	

## 固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	白色	
邵氏硬度 D	75	ASTM D-2240
导热系数	1.0 w/m.k	
降解温度	400°C	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1.5%	
工作温度范围*	-60°C—200°C	

## 储存和使用方法

产品低于-5°C冷冻环境中保存。使用前需要从冰箱拿出，30ml 室温下解冻 2 小时方可使用；大的包装需要更长的时间解冻；回温解冻时务必原包装恢复到室温避免在空气中吸潮；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件

### 注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

